

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,352,995,972.16	17.19
归属于上市公司股东的净利润	-242,117,693.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,588,082.98	不适用

经营活动产生的现金流量净额	306,117,266.28	40.68	
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	481,619,248.91	111.97	
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-1.96	不适用	
研发投入合计	470,149,903.00	36.32	
研发投入占营业收入的比例 (%)	34.75	增加 4.88 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	34,947,660,076.07	31,570,366,445.66	10.70
归属于上市公司股东的所有者权益	12,250,909,940.13	12,483,074,709.70	-1.86

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,679,416.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	55,447,168.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,217,615.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,367,061.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	1,882,039.55	
合计	56,470,389.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	40.68	主要系（1）随着公司业务规模的扩大，公司及产品在市场上的竞争地位、影响力、信用等进一步增强，与上下游合作伙伴建立了长期的战略合作关系，获得其供应保证和高优先级服务，以及高质量和极具成本竞争力的方案；（2）收到政府补贴款。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	111.97	主要系（1）受市场需求复苏的影响，公司收入规模扩大，较上年同期增长 17.19%；（2）公司通过成本控制和成本改善项目的推行，强化与核心战略合作伙伴的合作和协同降本提效等措施，现金毛利向好；（3）因公司符合高质量发展的集成电路企业要求，享受了财政部及税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减的优惠政策，报告期内产生的其他收益较上年增加。
研发投入	36.32	<p>主要系市场需求复苏，为了保障公司在未来市场旺盛需求阶段中能获得和巩固更多中高端技术及产品的市场份额，公司继续在 12 英寸车规级 BCD 平台、SiC MOSFET、功率模组等方面保持足够的研发投入强度。</p> <p>（1）车载领域</p> <p>高压 BCD、嵌入式数模混合控制 BCD 等平台发布；全新一代车载 IGBT 芯片和多款 SiC 模块以及混碳模块样品已在客户端验证通过，开始大规模客户导入和量产起量。</p> <p>（2）风光储充等工控领域</p> <p>结合终端多款新机型应用需求，公司研发并导入了多款产品，如大功率光伏逆变产品，大功率储能 PCS 产品和面向高压大功率风电的高功率产品，为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体 IGBT、SiC 芯片及模块。</p> <p>（3）家电应用领域</p> <p>研发出全系列智能功率模块产品，产品应用覆盖绿色和智能家电，已开始批量生产。</p> <p>这些研发成果带动公司在报告期内导入新客户 50 多家，客户覆盖汽车领域的国内外主机厂和 Tier 1，以及风光储、家电领域等行业头部，为未来收入的快速增长奠定了基础。</p>

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	188,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,152,000,000	16.35	1,152,000,000	1,152,000,000	无	
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	993,600,000	14.10	993,600,000	993,600,000	无	
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	230,400,000	3.27	230,400,000	230,400,000	无	
绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	216,000,000	3.07	216,000,000	216,000,000	质押	160,000,000
宁波振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	181,440,000	2.58	181,440,000	181,440,000	无	
共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	153,000,000	2.17	153,000,000	153,000,000	无	
共青城橙海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	153,000,000	2.17	153,000,000	153,000,000	无	
MASTERWELL (HK) LIMITED	境内非国有法人	144,000,000	2.04	144,000,000	144,000,000	无	
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	139,680,000	1.98	139,680,000	139,680,000	无	
共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	126,000,000	1.79	126,000,000	126,000,000	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张跃军	15,101,593	人民币普通股	15,101,593
高盛公司有限责任公司	10,890,242	人民币普通股	10,890,242
UBS AG	8,707,054	人民币普通股	8,707,054
尚融资本管理有限公司	6,853,710	人民币普通股	6,853,710
赵智信	4,221,960	人民币普通股	4,221,960
应欢如	4,120,592	人民币普通股	4,120,592
王乐康	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
韩景华	3,186,500	人民币普通股	3,186,500
危超明	2,880,784	人民币普通股	2,880,784
领航投资澳洲有限公司	2,616,718	人民币普通股	2,616,718
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、越城基金与青岛聚源芯越二期存在关联关系； 2、中芯控股与青岛聚源芯越二期存在关联关系； 3、硅芯锐、日芯锐存在关联关系； 4、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯存在关联关系； 除了上述股东关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1) 公司回购事项进展情况：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司 2024 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024-021），董事长丁国兴先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份全部用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）。

2024 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 7 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

后续，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(2) 公司 2024 年限制性股票激励计划事项进展情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2024 年 4 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2024 年 4 月 15 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-023）及《芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 763 人，激励对象需满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求。公司层面业绩考核要求为：以公司 2021-2023 年营业收入均值为业绩基数，对每个归属期定比业绩基数的累计营业收入增长率进行考核，第一个归属期（2024 年）累计营业收入增长率目标值为 60%，第二个归属期（2024-2025 年）累计营业收入增长率目标值为 254%，第三个归属期（2024-2026 年）累计营业收入增长率目标值为 508%。

2024 年 4 月 25 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造

股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-030），对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,804,957,714.89	3,995,220,464.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,821,164.00	50,370,000.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,553,316.35	550,294,845.42
应收款项融资		
预付款项	193,289,878.62	145,743,117.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,660,576.08	21,912,970.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,924,885,386.80	1,983,769,298.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,458,738,914.94	290,339,202.48
流动资产合计	10,179,906,951.68	7,037,649,899.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	418,782,638.89	217,101,736.11
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,490,952.38	60,925,427.40
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,334,895.91	69,637,873.79
固定资产	20,546,297,916.42	20,997,136,847.33
在建工程	1,158,091,246.64	1,252,287,367.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,375,804.86	35,111,937.50
无形资产	937,791,277.21	978,141,114.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	61,364,738.52	56,857,700.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,229,223,653.56	815,516,542.01
非流动资产合计	24,767,753,124.39	24,532,716,545.82
资产总计	34,947,660,076.07	31,570,366,445.66
流动负债：		
短期借款	2,261,845,611.91	2,596,241,971.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	992,673.14
衍生金融负债		
应付票据	287,274,511.04	158,214,713.06
应付账款	2,705,170,399.78	2,762,871,594.56
预收款项		
合同负债	462,326,602.57	571,727,634.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,781,458.54	139,656,094.54
应交税费	158,244,648.68	34,871,869.46
其他应付款	15,733,330.88	24,545,722.25
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	454,155,902.10	453,680,107.51
其他流动负债	55,101,734.17	66,327,044.96
流动负债合计	6,486,634,199.67	6,809,129,425.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,923,668,814.92	6,718,717,801.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,225,816.53	16,430,872.42
长期应付款	1,497,576,966.69	1,512,591,888.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	856,750,585.06	665,117,481.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,290,222,183.20	8,912,858,044.59
负债合计	18,776,856,382.87	15,721,987,469.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,045,747,150.00	7,044,602,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,489,203,791.64	9,480,395,743.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,284,041,001.51	-4,041,923,308.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,250,909,940.13	12,483,074,709.70
少数股东权益	3,919,893,753.07	3,365,304,266.00
所有者权益（或股东权益）合计	16,170,803,693.20	15,848,378,975.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,947,660,076.07	31,570,366,445.66

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王韦

会计机构负责人：张毅

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,352,995,972.16	1,154,539,275.25
其中：营业收入	1,352,995,972.16	1,154,539,275.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,039,548,677.57	1,594,028,971.57
其中：营业成本	1,443,312,704.15	1,126,916,378.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,048,520.39	2,545,725.43
销售费用	8,182,802.60	7,423,056.91
管理费用	29,892,595.76	27,289,114.80
研发费用	470,149,903.00	344,876,451.72
财务费用	75,962,151.67	84,978,244.68
其中：利息费用	110,500,257.70	126,796,991.73
利息收入	30,427,791.44	15,475,012.86
加：其他收益	320,749,001.41	29,629,306.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,982,320.86	12,238,979.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,434,474.96	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,235,295.13	-3,085,271.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	301,945.83	-228,697.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-287,431,709.07	-219,444,467.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,679,416.04	39,501.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-651,395,267.29	-620,340,344.80
加：营业外收入	1,367,063.93	38,101.30
减：营业外支出	2.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-650,028,206.01	-620,302,243.50
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,028,206.01	-620,302,243.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,028,206.01	-620,302,243.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,117,693.08	-499,593,092.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-407,910,512.93	-120,709,150.53
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-650,028,206.01	-620,302,243.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,117,693.08	-499,593,092.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-407,910,512.93	-120,709,150.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张毅

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,280,918,522.10	1,434,645,051.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	641,999.34	115,366,924.17
收到其他与经营活动有关的现金	358,657,950.28	120,447,126.82
经营活动现金流入小计	1,640,218,471.72	1,670,459,102.49
购买商品、接受劳务支付的现金	472,240,508.47	1,022,455,591.18
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	365,280,194.25	347,094,265.62
支付的各项税费	450,846,642.73	57,257,017.93
支付其他与经营活动有关的现金	45,733,859.99	26,058,621.70
经营活动现金流出小计	1,334,101,205.44	1,452,865,496.43
经营活动产生的现金流量净额	306,117,266.28	217,593,606.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	562,500.00	11,652,951.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	1,689,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,562,500.00	1,700,652,951.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,405,569,358.57	2,784,205,054.92
投资支付的现金	208,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00	1,400,068,499.00
投资活动现金流出小计	2,363,569,358.57	4,184,273,553.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,006,858.57	-2,483,620,602.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,682,752.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,332,476,529.53	2,837,356,948.39
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,298,159,282.03	4,337,356,948.39
偿还债务支付的现金	1,408,599,103.59	1,888,320,466.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,840,833.44	108,688,003.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

2024 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	6,228,431.59	
筹资活动现金流出小计	1,520,668,368.62	1,997,008,470.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,777,490,913.41	2,340,348,478.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,171,710.00	-8,942,550.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,859,429,611.12	65,378,931.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
六、期末现金及现金等价物余额	5,764,657,714.89	1,685,750,132.61

公司负责人：赵奇

主管会计工作负责人：王韦

会计机构负责人：张毅

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日